

VUE 400-P-NexGen 超声波扫描显微镜

半导体封装失效分析
空洞 · 剥离 · 裂纹 · 分层 · 内部缺陷

客户界面

双高清22" LED显示器

治具

托盘治具

仪器仪表

数字脉冲接收器

数字转换器 (Max 12 GHz)

用户体验特点

双 JEDEC 托盘

高清LED照明

不锈钢水槽

免维护扫描X轴:

扫描轴:

最大扫描速度:

扫描极限范围:

线性伺服系统

1500 mm/s

+/- 0.5 micron

X轴扫描范围: 400 mm

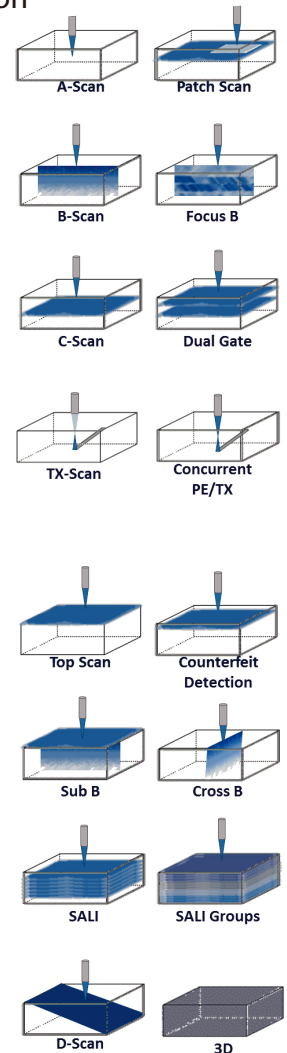
Y轴扫描范围: 380 mm

Z轴聚焦范围: 35 mm

C-Scan 范围: 360 mm x 350 mm

T-Scan 范围: 360 mm x 220 mm

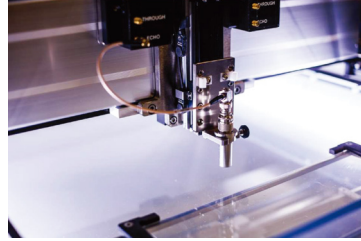
设备重量: 250 Kg.



VUE 400-P-NexGen 超声波扫描显微镜

软件运行模式:

- 基本模式 (简单的用户界面)
- 高级模式 (详细分析界面)
- 生产模式 (自动扫描界面)
- 离线分析模式 (虚拟扫描界面)



OKOS Digital Imaging System (ODIS)



VUE 400-P 高清成像超过了现代标准，为半导体制造设施提供优质的失效分析功能。基于当前的平台和行业反馈，ODIS是最新的声学显微镜软件，具有丰富的技术内容。通过定量软件功能提供高级分析，适用于零件的测量和分类。

ODIS 的离线分析版本允许客户在非扫描计算机下进行虚拟扫描，以便客户查看和分析数据，实时分析或收集数据和审查结果。

- 产品真伪检测
- 产品可靠性检测
- 工艺有效性验证
- 供应商资格验证
- 产品检验
- 质量控制
- 失效分析
- 研究与试验发展

特定应用的探头
提供高质量的分辨率
多探头设计，增强扫描能力

